



**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

## Многофункциональная высокоточная установка монтажа кристаллов NUCLEUS



Установка Nucleus предназначена для производства сложных многокристалльных модулей, в том числе по технологиям 2.5D-интеграции, сборки на пластине (FOWLP – Fan-Out Wafer Level Packaging), «Кристалл на пластине» (C2W – Chip to Wafer), термокомпрессионного монтажа кристаллов. Благодаря большому рабочему полю, установка также может быть использована для производства компонентов по технологии сборки на панели (PLP – Panel Level Packaging).

**Установка может быть использована в помещении с классом чистоты ISO5 (Class 100).**

Параметры	NUCLEUS
Точность монтажа	$\pm 4,0$ мкм, 3 $\sigma$ , $\pm 0,1^\circ$ (прямой монтаж кристаллов); $\pm 2,5$ мкм, 3 $\sigma$ , $\pm 0,03^\circ$ (флип-чип)
Производительность	До 4000 кристаллов в час (прямой монтаж); до 5000 кристаллов в час (флип-чип)
Габариты кристаллов	От 0,5 x 0,5 до 25 x 25 мм
Толщина кристаллов	От 50 до 1000 мкм
Диаметр пластин	До 300 мм
Типы подложек	Платы, пластины, выводные рамки
Габариты подложек	Длина от 50 до 330 мм; ширина от 50 до 330 мм; толщина до 3 мм
Рабочая область	До 330 x 330 мм
Подогрев рабочего стола	До 250°C $\pm 5^\circ$ C (опция)
Тип эжектора	Карусельный, до 5 эжекторов
Количество монтажных головок	5
Сила прижима	0,5–50 Н; 10–300 Н (термокомпрессия)
Подогрев инструмента монтажа кристалла	До 350°C
Электропитание	380 В; 50 Гц; 10 кВт
Сжатый воздух, вакуум	Не менее 4 бар, 250 л/мин, 80 кПа
Габариты, вес	1460 x 2300 x 2100 мм, 3000 кг

ООО «ЛионТех-С»  
mail@liontech.ru



Звонок по России бесплатный:

**8 800 555 6889**

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

[www.liontech.ru](http://www.liontech.ru)

*Технологическое оборудование и расходные материалы  
для производства электроники*